



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	半导体器件制造方法
专利类别:	国际专利
申请号:	14/725,496
申请日期:	2015-05-29
专利号:	9,337,102
第一发明人:	殷华湘;秦长亮;马小龙;王桂磊;朱慧琰
实施情况:	授权
专利证书号:	9,337,102
其它备注:	先导中心

